## 第73回応用物理学会春季学術講演会シンポジウム T13 原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) の 解析技術と応用技術(3)

日時:2026年3月15日(日)9:00-18:30(予定)

(前半:英語セッション,後半:日本語セッション予定)

会場:東京科学大学 大岡山キャンパス(応用物理学会会場)

微細化や三次元化が進む半導体製造プロセスにおいて、原子層堆積(ALD: Atomic Layer Deposition)や原子層エッチング(ALE: Atomic Layer Etching)などの原子層プロセス (ALP: Atomic Layer Process) は益々重要性を増している。その反応メカニズムや速度論等の基礎は、応用分野を超えた共通性がある。このようなプロセスサイエンスとALPの最先端技術動向を議論し、材料・デバイス・プロセス等の幅広い分野の研究者・技術者が問題意識を共有し、この分野の更なる技術革新を推進する事を目的とする。

## 【招待講演者】

Han-Bo-Ram Lee (Incheon National University)

[New Paradigms in Atomic Layer Deposition for 3D Semiconductor Device Fabrication]

**Heeyeop Chae** (Sungkyunkwan University)

[Plasma-Based Atomic Layer Etching for Semiconductor Device Fabrication]

Rong Chen (Huazhong University of Science and Technology)

[Thin Film Atomic Layer Deposition and Selective Processes]

Mikko Utriainen (Chipmetrics Ltd)

「Ultra-High Aspect Ratio Test Structures in ALP Process Analytics」

Sumit Agarwal (Colorado School of Mines)

[Development of Atomic Layer Deposition and Atomic Layer Etching Processes for Semiconductor Device Fabrication using In Situ Diagnostics]

劉 吴南 (東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社)

「Enabling High Temperature Three-color Area Selective Deposition of SiN through controlled surface fluorination(仮題)」

若林整 (東京科学大学)

「先端LSI向け3Dナノデバイスに必要不可欠なAtomic-Layer Process」

水谷 文一 (株式会社 高純度化学研究所)

「高純度薄膜の原子層堆積用ガリウムプリカーサーの開発」

伊藤 昌平 (オックスフォード・インスツルメンツ株式会社)

「Atomic scale Processing for Quantum computing - ALD and ALE-(仮題)」

主催:プラズマエレクトロニクス分科会,シリコンテクノロジー分科会

世話人:霜垣幸浩(東京大学),浜口智志(大阪大学),唐橋一浩(名古屋大学),百瀬健(熊本大学), 廣瀬文彦(山形大学),東雲秀司(東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社)

- ※ 一般講演募集中(2026年1月8日17:00締切)
- ※ 協賛募集中(プログラム記載,資料配布・展示)